

福州达华智能科技股份有限公司 关于公司向兴业银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月30日,福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》,同意公司向兴业银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币1.5亿元的授信额度,该额度用于办理贷款借新还旧业务,该笔授信由公司名下位于中山的房地产提供抵押担保,实际金额及授信期限以银行审批为准。

一、申请授信额度具体事宜

鉴于公司的发展和生产经营需要,公司拟向兴业银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币1.5亿元的授信额度,该额度用于办理贷款借新还旧业务,该笔授信由公司名下位于中山的房地产提供抵押担保,实际金额及授信期限以银行审批为准。

董事会授权董事长陈融圣先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项不构成关联交易,在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

二、董事会意见

公司董事认为:经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度,有助于解决其生产经营所需资金的需求,有助于保障公司的持

续、稳健发展，进一步提高其经济效益。

三、备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月一日